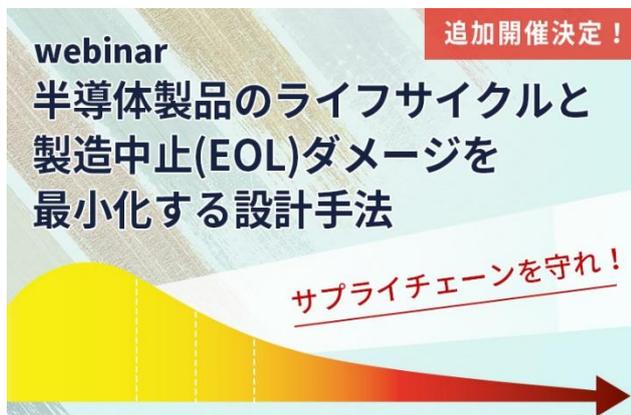


【7/20・8/5 無償】電子機器設計者・購買担当者向けウェビナー
「サプライチェーンを守れ！半導体製品のライフサイクルと
製造中止（EOL）ダメージを最小化する設計手法」
～好評につき追加開催決定！～

FPGAやメモリ製品などの半導体製品を提供する株式会社 P A L T E K（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：高橋 忠仁、証券コード：7587、以下 P A L T E K）は、電子機器設計者・購買担当者向けウェビナー「サプライチェーンを守れ！半導体製品のライフサイクルと製造中止（EOL）ダメージを最小化する設計手法」と題し、過去開催して好評だったウェビナーを2021年7月20日（火）と8月5日（木）に追加開催します。



■開催背景

半導体の需要は、新型コロナウイルスをきっかけに広がったテレワーク用のパソコンや販売が急回復した自動車向けなどに増加しています。

その一方で、半導体の供給面では、半導体メーカーの工場火災などのトラブル発生や想定以上の需要の高まりにより、半導体提供までの期間が延伸される状況が続いています。

また、半導体メーカーにおける製品ポートフォリオの最適化やより新しい機能・性能の製品の投入、製品の生産効率の向上などの観点から定期的に生産中止（EOL）なども行われ、製品開発におけるリスク管理はますます重要になっています。

今回のウェビナーでは、半導体商社であり、産業用組み込み基板を開発・製造する P A L T E K が、基板開発において実践した考え方や設計手法について余すことなく紹介します。

■アジェンダ

1. 半導体調達を取り巻く環境の変化
2. 半導体のライフサイクル
3. 半導体不足/生産中止（EOL）発生のメカニズム
4. 半導体不足/生産中止（EOL）のダメージを最小化する設計手法

■ 開催概要およびお申込みページ

開催日時	:	2021年7月20日(火) 10:00~11:00
参加費	:	無償
開催方法	:	ウェビナー形式（チャット機能によりリアルタイムで質疑応答可能です。） 本Webセミナーは「zoom」を利用します。
お申込みURL	:	https://www.paltek.co.jp/techblog/seminar/210720-01 ※2021年7月19日(月) 12:00頃受付終了

開催日時	:	2021年8月5日(木) 10:00~11:00
参加費	:	無償
開催方法	:	ウェビナー形式（チャット機能によりリアルタイムで質疑応答可能です。） 本Webセミナーは「zoom」を利用します。
お申込みURL	:	https://www.paltek.co.jp/techblog/seminar/210805-01 ※2021年8月4日(水) 12:00頃受付終了

※競合製品取り扱い企業様の申込については、お断りする場合がありますので予めご了承ください。

開催前日までにお申込みいただいた方へウェビナー入場用のURLを別途メールにてお知らせいたします。メールが届かない方は、迷惑メールフォルダをご確認いただくか、お問合せフォームにてご連絡ください。

株式会社PALTEKについて

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェアなどの設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。

PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：ニュースリリースに関するお問い合わせ

会社名：株式会社PALTEK
担当者：広報担当 柴崎、寺田
メールアドレス：pr@paltek.co.jp
所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F
電話：045-477-2072